



低翘曲(~230℃)

【常规材料】

金属、其他热塑型树脂 (PEEK、PES)

【问题点】

金属：金属粉削 (对IC芯片的影响)

树脂：成形品尺寸精度 (翘曲)

【要求特性】

低翘曲、抗静电 ($10^6 \sim 10^{10} \Omega$)

AURUM™的优异性

- 成形品精度 (低翘曲)
- 较少的金属杂质

高温环境下也可以维持成形品精度 (翘曲)

👉 AURUM™推荐牌号：JCF3025